シングルチップマイコン注文仕様書

＊この欄は記入しないでください。

（1）基本項目･･･空白部は記入または該当項目にチェックしてください。

マイクロコンピュータファミリ	HD	動作周波数＊4/電圧	MHz V
用　途 ＊1	□民生用 □業務用（産業・工業用等）	機　能 ＊2	
ROMコード名			
ROMコード・メディア	□ＲＯＭ伝送（照会No.：　　）		
外形 ＊3	□ＤＰ－（　　）　□ＦＰ－（　　）　□ＴＦＰ－（　　） □ＣＰ－（　　）　□その他－（　　）（例):ＤＰ-(64S),ＦＰ-(80B)		
動作温度 ＊3	□標準仕様　□広域温度仕様（Ｉ仕様：Ta= -40 ℃ ～ +85 ℃） □高信頼度仕様（Ｊ仕様：Ta= -40 ℃ ～ +85 ℃）　□その他特仕（　　）		
特別仕様 (製品特仕、マーク特仕等)			

＊1 LSIが使用される機器について詳しく記入してください。　（例）：カセットデッキ、VTR、エアコンなど
＊2 実際に制御している機能を詳しく記入してください。　（例）：自動選曲、チューナー、温度制御など
＊3 外形・動作温度については、製品により設定されていない外形・仕様がありますのでご注意ください。
＊4 H8S,SH,H8シリーズ(H8/300Lシリーズを除く)マイコンの場合、製品の動作周波数バージョンを記入してください。
その他の製品の場合、記入不要です。

（2）使用環境チェックリスト
このチェックリストはLSIの信頼性設計の参考資料とするもので、特性保証値を決定するものではありません。したがって、実際の製品の保証については（1）基本項目に記載していただいた内容で決定されますのでご注意ください。

マイクロコンピュータLSI周囲温度	平均	℃
	範囲	℃　～　℃
マイクロコンピュータLSI周囲湿度	平均	%
	範囲	%　～　%
マイクロコンピュータLSIへの通電時間	平均	時間/日
信頼性目標値		□500fit　□1000fit　□その他（　　fit）
ＡＱＬ		□1.0 %　□0.65 %　□0.4 %　□その他（　　）
面付けパッケージの実装法	実装方法	□リードディップ　□ベーパーフェーズリフロー　□赤外線リフロー □エアリフロー　□ウェーブソルダ　□半田ゴテ □その他（　　）
	実装条件	温度　℃　秒（　　）
	＊詳細については当社営業窓口にお問い合わせいただくか、面実装マニュアルを御参照ください。	
特記事項		

（3）チェックサム
チェックサムは提出していただくROMデータの先頭アドレスから最終アドレスまでの値の下4桁を記入してください。

必ず記入してください。	
アドレス	チェックサム値
0 ～（　　）	

発注日	年	月	日
貴社名			
部署名			
御署名			